

2027年3月期 第1四半期 決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2026年8月6日

業績サマリー

■ 売上高・利益

➤ 前年比 減収減益

売上高 200億円（7%減）、営業利益 29億円（30%減）

半導体後工程は生成AI需要を背景に好調に推移し増収増益。一方、半導体前工程は顧客の投資計画の見直しや、一部案件の納入時期変更に伴う進行スケジュールの調整を行った結果、当初計画から売上の一部が2Q以降へシフトし、全体では減収減益。

■ 受注高

➤ 前年比 大幅に増加

受注高520億円（前年比191%増）

半導体後工程は生成AI需要を背景に、先端パッケージ向け装置が好調に推移し大幅に増加。

半導体前工程はロジック/ファウンドリ向け装置、Siウェーハ向け装置がともに堅調に推移。

■ 受注残高

➤ 2026年6月末 803億円

■ 業績予想

➤ 通期業績予想は前回予想から変更なし

業績結果（対前年）

(億円)	2025年度				2026年度	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	215	208	239	218	200	-7%
営業利益	41	35	48	29	29	-30%
ROS	18.9%	16.9%	19.9%	13.4%	14.2%	-4.7pt
経常利益	41	33	47	28	29	-28%
当期純利益	29	24	35	24	19	-33%
受注高	179	233	281	184	520	+191%

■ 売上高

前年比7%減収（215億円 ⇒ 200億円）

- 半導体前工程の売上減少により全体で減収。
半導体後工程は増収。

■ 営業利益

前年比30%減益（41億円 ⇒ 29億円）

- 半導体前工程の売上減少及び販管費の増加などにより減益。

■ 受注高

前年比191%増加（179億円 ⇒ 520億円）

- 半導体後工程は生成AI需要を背景に大幅に増加。半導体前工程はロジック/ファウンドリ向け装置、Siウェーハ向け装置ともに堅調に推移。

セグメント別業績結果（対前年）①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程

➤ 売上高 前年比26%減（117億円 ⇒ 87億円）

半導体前工程は顧客の投資計画の見直しや、一部案件の納入時期変更に伴う進行スケジュールの調整を行った結果、当初計画から売上の一部が2Q以降へシフトし減収。

FPD前工程は市況の影響により減少。

➤ セグメント損失 前年比18億円減（17億円 ⇒ -1億円）

顧客の投資計画の見直しや一部案件の調整による減収、及び成長投資に伴う販管費の増加により減益。

➤ 受注高 前年比61%増（87億円 ⇒ 140億円）

半導体前工程はロジック/ファウンドリ向け装置、Siウェーハ向け装置がともに堅調に推移。

FPD前工程は市況の影響により減少。

*従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していた海外関係会社4社を、各セグメント由来に区分して計上しています。

セグメント別業績結果（対前年）②

■ メカトロニクスシステム部門

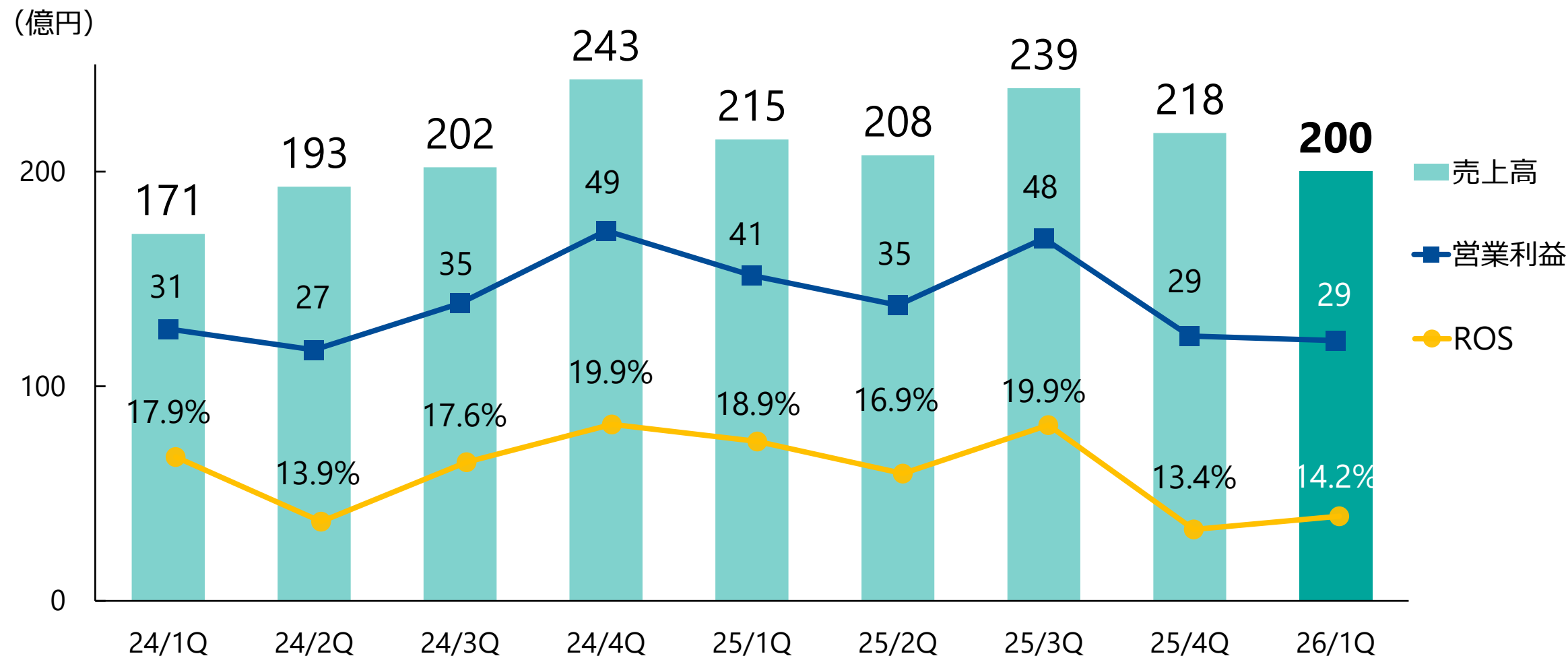
*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程、真空応用

- 売上高 前年比22%増（85億円 ⇒ 104億円）
半導体後工程は生成AI需要を背景に先端パッケージ向け装置が増加。
FPD後工程は前年同等、真空応用装置は低調で減少。
- セグメント利益 前年比29%増（24億円 ⇒ 31億円）
半導体後工程の売上増加により増益。
- 受注高 前年比367%増（80億円 ⇒ 371億円）
半導体後工程は生成AI需要を背景に先端パッケージ向け装置が大幅に増加。
FPD後工程及び真空応用装置は市況の影響により低調に推移。

*従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していた海外関係会社4社を、各セグメント由来に区分して計上しています。

売上高・利益・ROS

ROS 14.2%

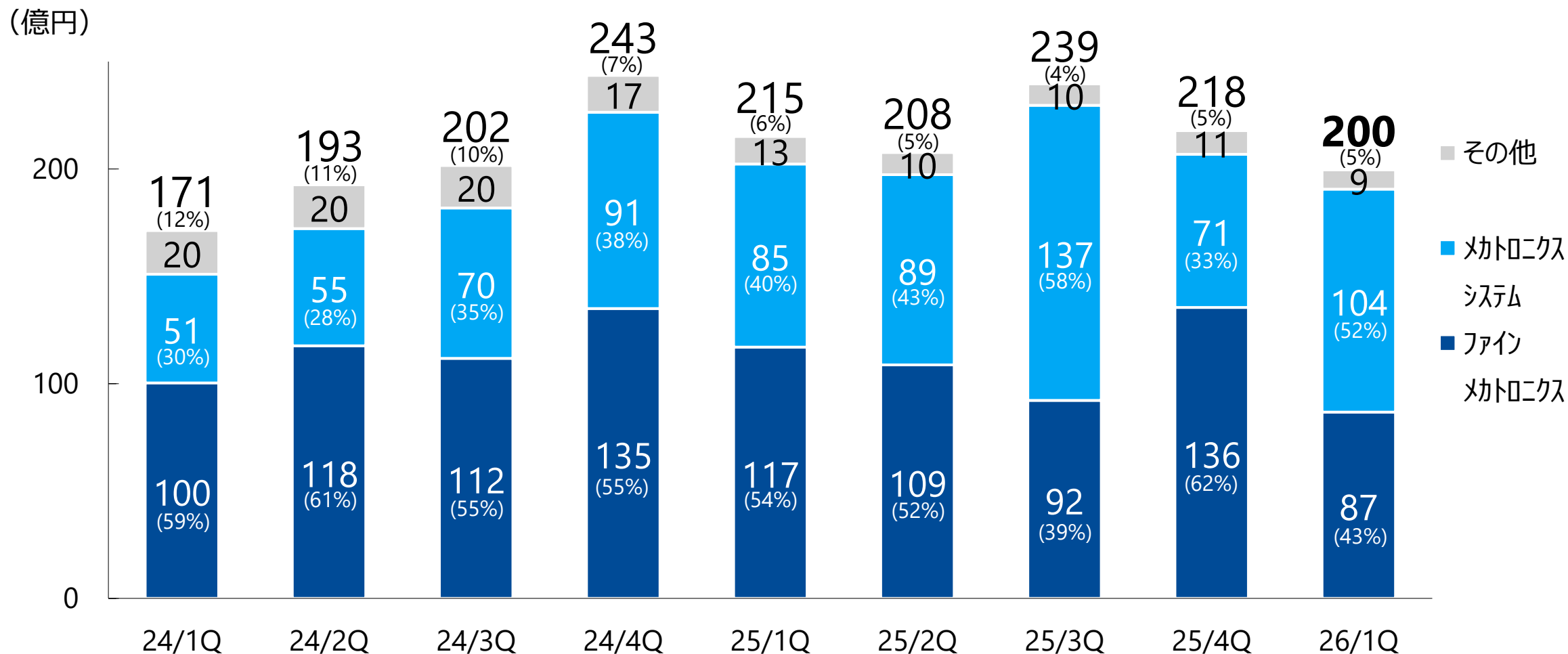


セグメント別売上高

≫ ファインメカトロニクス 43%
≫ メカトロニクスシステム 52%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程、真空応用

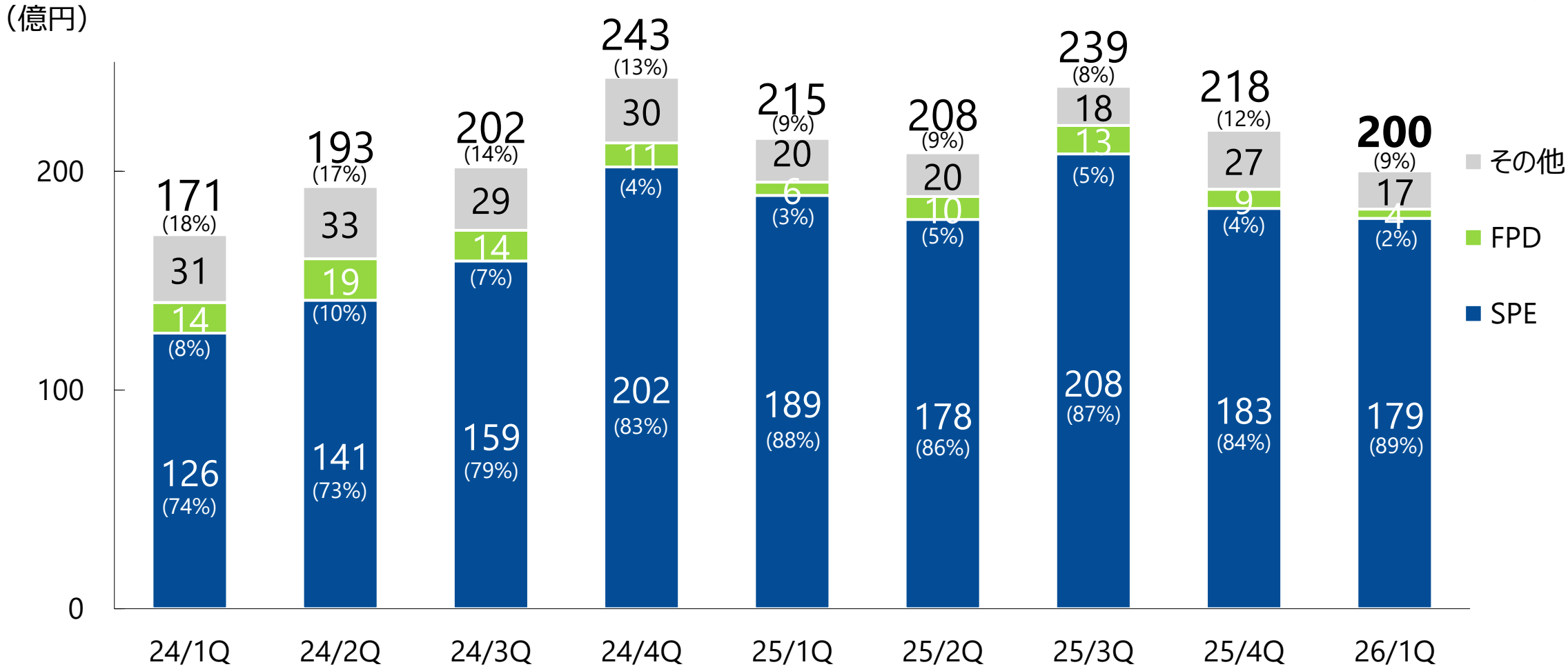


*従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していた海外関係会社4社を、各セグメント由来に区分して計上しています。

分野別売上高

» SPEの売上順調（89%）
SPE売上高179億円の内、GNT 122億円（68%）

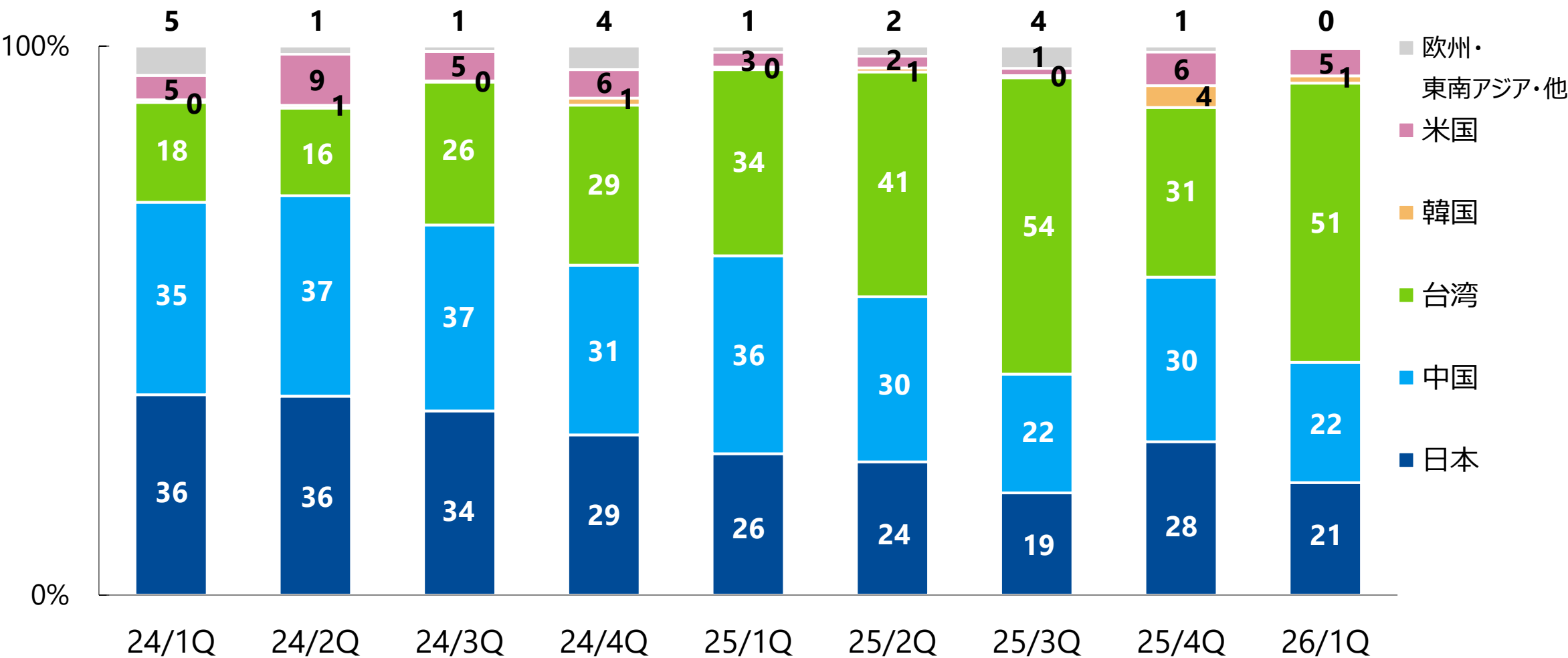
* SPE：半導体前・後工程
FPD：FPD前・後工程
* GNT：現中期経営計画
グローバルニッチトップ対象製品群



地域別売上高比率

海外向け79%（台湾51%、中国22%）

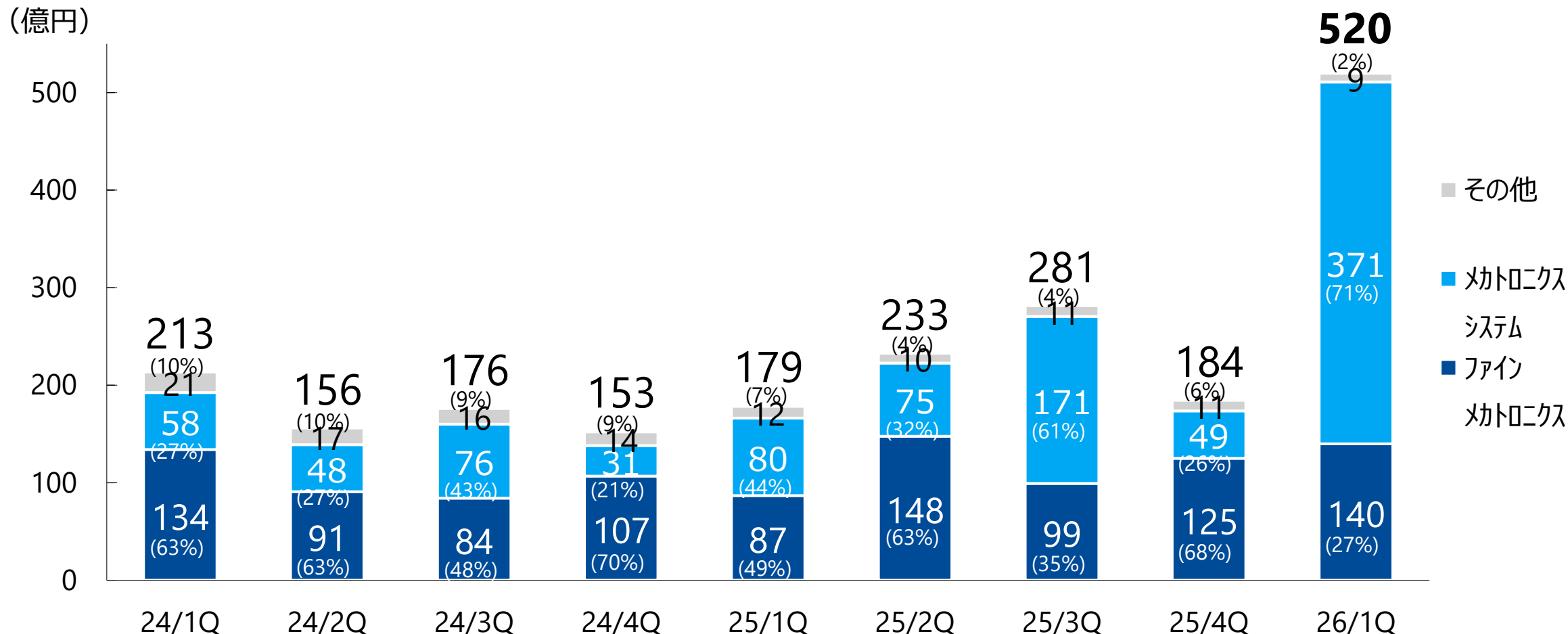
* 仕向地で区分



セグメント別受注高

» 半導体後工程は生成AI需要を背景に先端パッケージ向け装置が好調
セグメント全体受注高 80億円 ⇒ 371億円（前年同期比367%増）

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程
エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程、真空応用

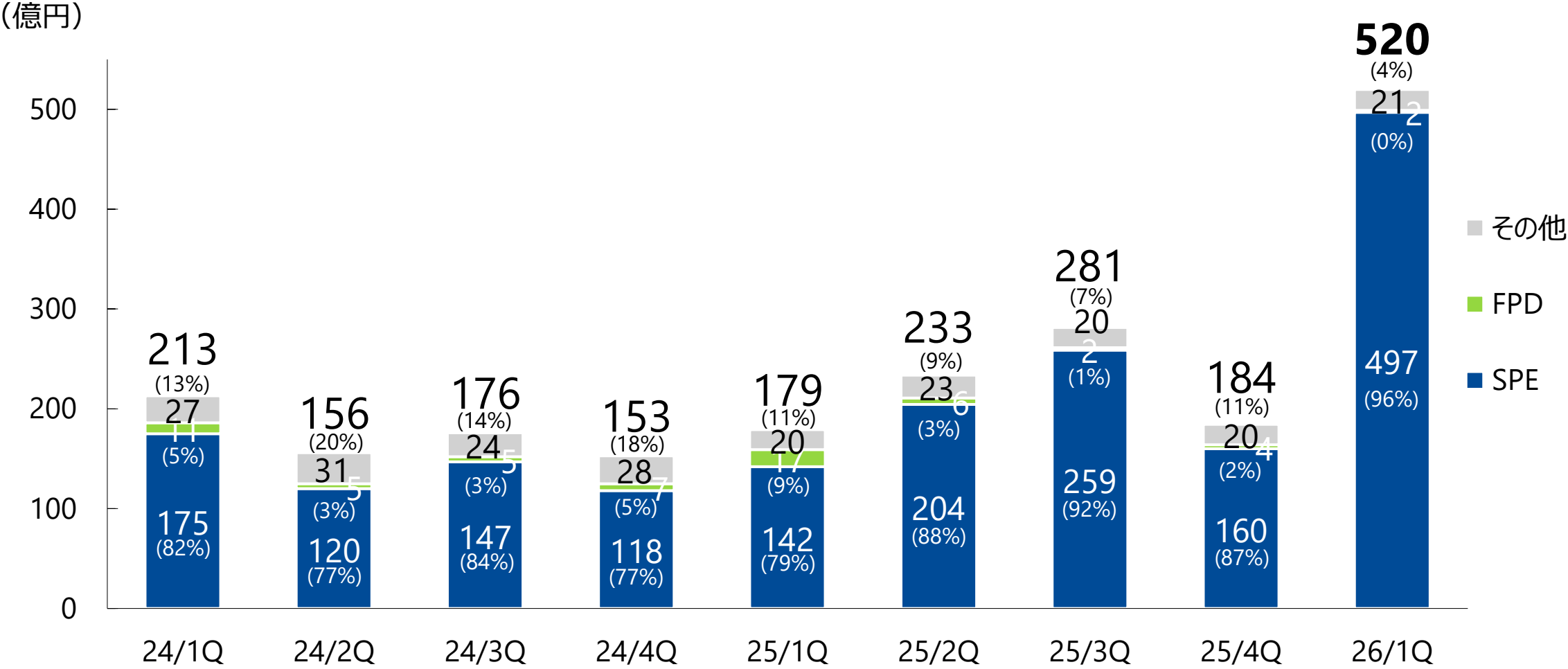


*従来ファインエレクトロニクスセグメントに一括計上していた海外関係会社4社を、各セグメント由来に区分して計上しています。

分野別受注高

» SPEの受注好調、比率は96%で過去最高
SPE受注高497億円の内、GNT 416億円（84%）

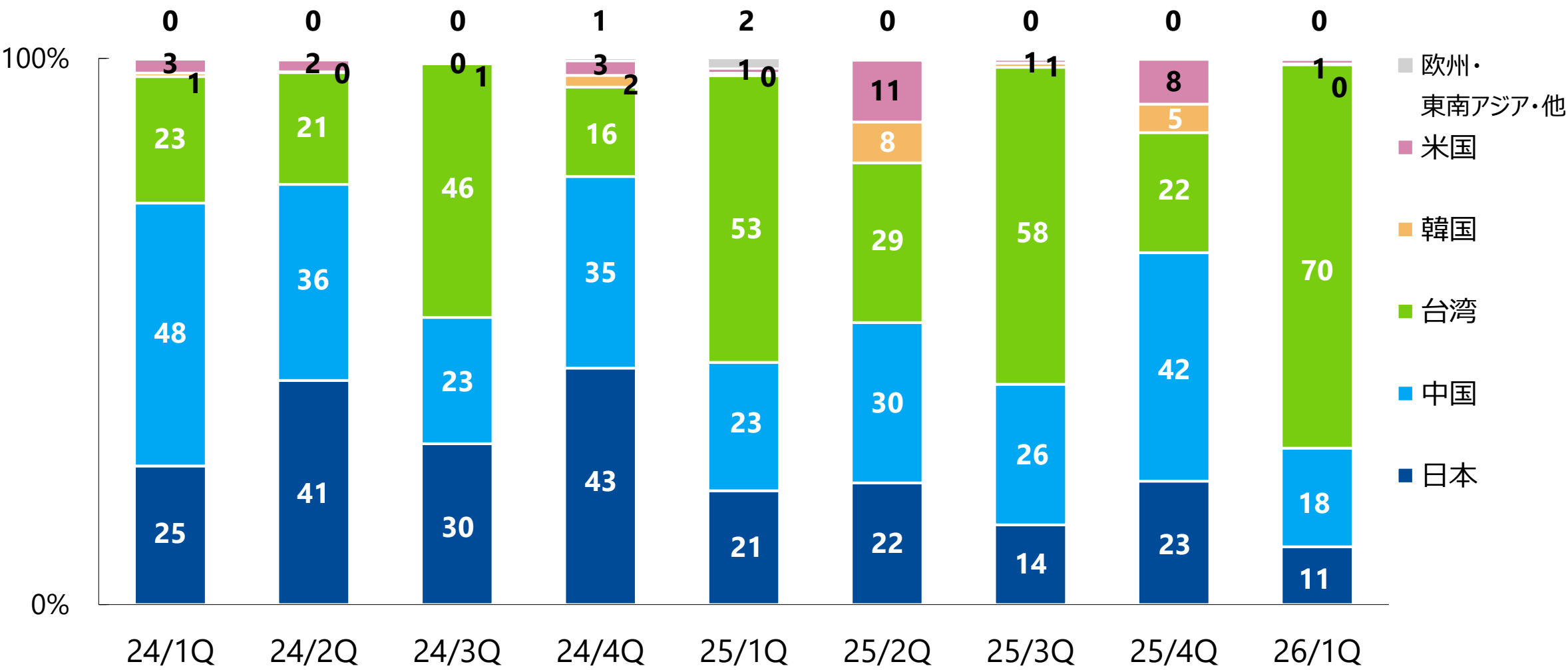
* SPE：半導体前・後工程
FPD：FPD前・後工程
* GNT：現中期経営計画
グローバルニッチトップ対象製品群



地域別受注高比率

海外向け89%（台湾70%、中国18%）

* 仕向地で区分



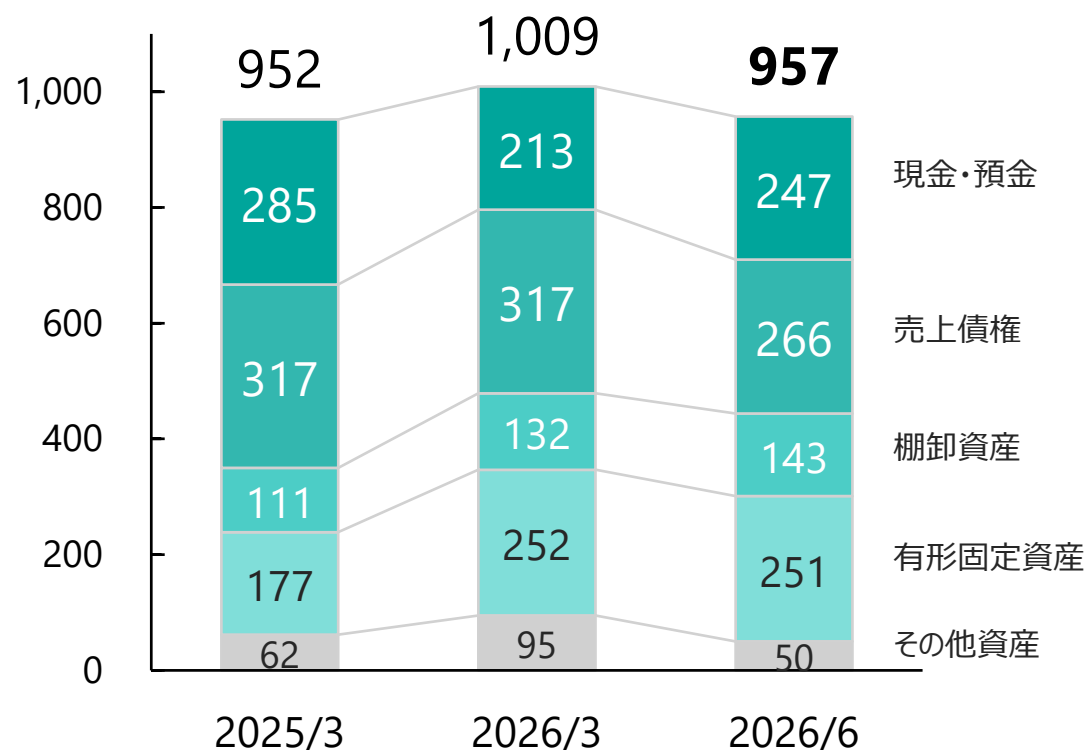
貸借対照表

》 自己資本比率 55.1% ('26/3) → 56.0% ('26/6)

》 D/Eレシオ 0.16倍 ('26/3) → 0.16倍 ('26/6)

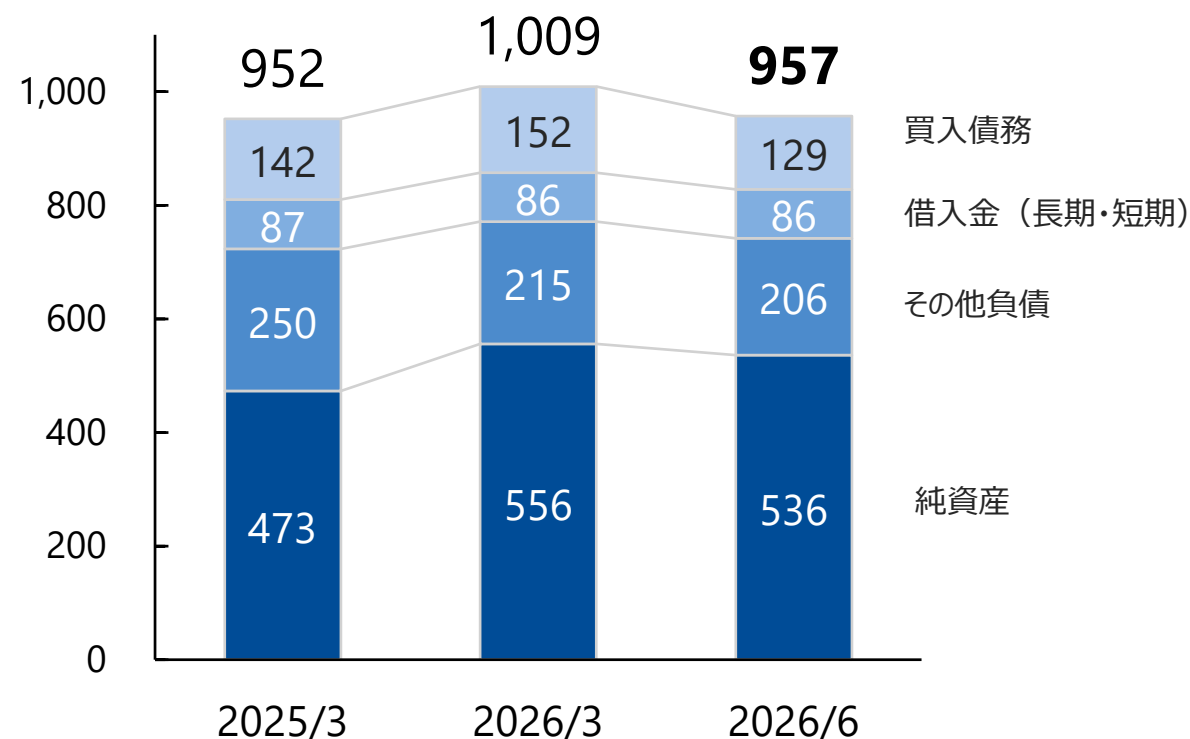
資産

(億円)



負債及び純資産

(億円)



業績予想

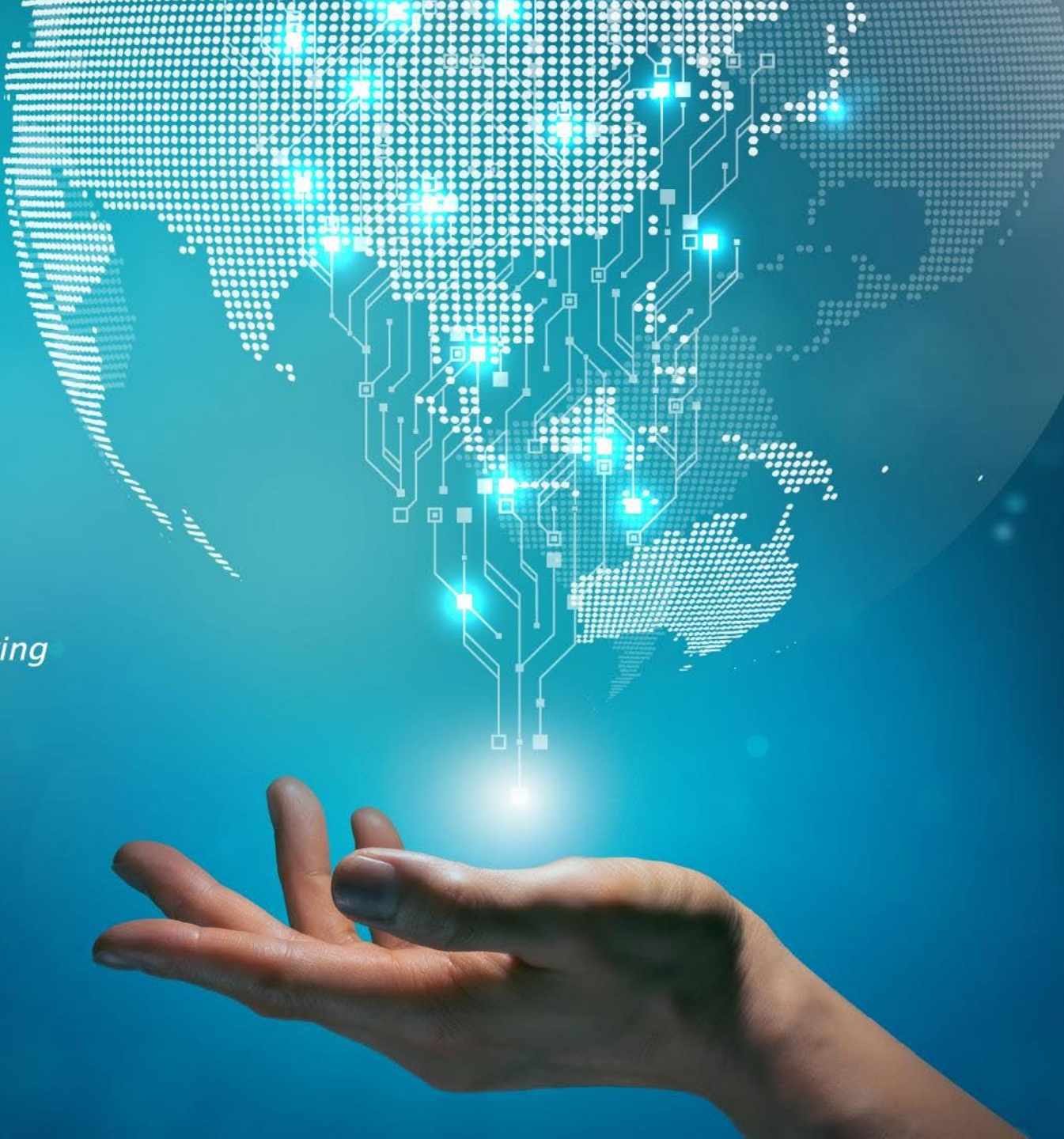
» 前回（2026年5月）予想から通期業績予想の変更なし

(億円)	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度予想
売上高	610	676	809	880	990
営業利益	109	117	141	153	160
ROS	17.9%	17.3%	17.5%	17.3%	16.2%
経常利益	105	116	140	149	157
当期純利益	92	88	103	112	119
ROE	31.9%	24.5%	24.0%	21.7%	20.2%
FCF	32	37	38	-35	5

トピックス

- 先端パッケージ向け装置：生成AI用GPU用途中心に引き続き受注好調
- 先端パッケージ向けPLP用途のウェット処理装置：量産展開に向け開発継続中
【ご参考：ニュースリリース】< [次世代半導体パッケージ向けパネル用ウェットスピン装置「PD-Series」を開発](#) >
- 枚葉式リン酸エッチング装置：引き合い継続中、引き続き堅調
- 枚葉式Siウェーハ洗浄装置：引き合い増加中、更なる回復に期待
- マスク向け装置：エッチング装置、洗浄装置とも引き合い増加

【ご参考：当社ホームページ】< [半導体製造装置](#) >

A hand is shown from the bottom right, palm up, holding a glowing digital world map. The map is composed of a grid of small dots and lines, with some dots highlighted in bright blue and white, suggesting data points or active connections. The background is a solid blue color with a subtle gradient.

この先もずっと、 人と技術で 社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、

「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で

お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、

豊かな社会の実現を支えてまいります。

見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。